**电子组件拆焊高阶检修技术竞赛**

**竞赛规则**

1. **参赛资格：** 
   1. 本科院校及高、中职在学学生(含应届毕业生、研究生、在职生)皆可依组别报名参加。
   2. 每队作品需要有一位指导老师，报名1位同学。指导老师可同时指导多组队伍，参赛同学仅能报名一队。违者将判定丧失资格。
2. **竞赛说明：**
   1. **竞赛方式：**
      1. **高校组：**依电子组件拆焊**专家级**能力认证正式认证内容实施，需搭配竞赛时间依 大会规定之时间内认定奖项名次，竞赛内容请参考【电子组件拆焊专家级术科测验参考数据】。
      2. **中职组:** 依电子组件拆焊**专业级**能力认证正式认证内容实施，需搭配竞赛时间依大会规定之时间内认定奖项名次，竞赛内容请参考【电子组件拆焊专业级术科测验参考数据】。
   2. **评分标准**
      1. 本竞赛分为：高校组及中职组
      2. 评分标准依电子组件拆焊专业级/专家级认证内容实施
      3. 此竞赛评分分为两部份：
         1. 第一部份：参赛者完成拆焊电路板拆卸进行作业评分。
         2. 第二部份：完成拆焊成品板及周边圆孔板的焊接并进行组合功能测试、评分。
      4. 测试板功能测试操作需由参赛人员自行操作，不得要求评审或旁人协助，违者取消资格。
      5. 提出评分后，参赛者不得再进行调整或维修动作。
      6. 参赛者提出组合功能测试评分要求之时间，由评审于评分表中填写勾选完工时间，即为此次术科竞赛总花费时数。
      7. 得奖名次门坎：一等奖(10%)、二等奖(20%)、三等奖(30%)
3. **竞赛流程**
4. **梯次时间：**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 梯 次 | 时 间 | 时 数 | 说 明 |
| **第一梯次** | 9:30~09:45 | 15分钟 | 报到 |
| 09:45~10:00 | 15分钟 | 宣布规则、抽签、拆焊成品板及测试板检验 |
| 10:00~12:30  (参赛者需待评分  完成后才可离场) | 150分钟 | 1. 10分钟内拆焊板功能有瑕疵或异状   （要求更换不扣分）   1. 30分钟内材料包缺件（补零件不扣分，   仅限周边圆孔板SCBH材料包）   1. 竞赛流程：队伍进行拆焊作业，完成后举手进行评分。 |
| 12:30~13:00 | |  | 中午休息 |
| **第二梯次** | 13:00~13:15 | 15分钟 | 报到 |
| 13:15~13:30 | 15分钟 | 宣布规则、抽签、拆焊成品板及测试板检验 |
| 13:30~16:00  (参赛者需待评分  完成后才可离场) | 150分钟 | 1. 10分钟内拆焊板功能有瑕疵或异状   （要求更换不扣分）   1. 30分钟内材料包缺件（补零件不扣分，   仅限周边圆孔板SCBH材料包）   1. 竞赛流程：队伍进行拆焊作业，完成后举手进行评分。 |
| **第三梯次** | 16:00~16:15 | 15分钟 | 报到 |
| 16:15~16:30 | 15分钟 | 宣布规则、抽签、拆焊成品板及测试板检验 |
| 16:30~19:00  (参赛者需待评分  完成后才可离场) | 150分钟 | 1. 10分钟内拆焊板功能有瑕疵或异状   （要求更换不扣分）   1. 30分钟内材料包缺件（补零件不扣分，   仅限周边圆孔板SCBH材料包）   1. 竞赛流程：队伍进行拆焊作业，完成后举手进行评分。 |